

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2026-014

深圳市信维通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 967,568,638 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 3,811,631 股后的股份总数 963,757,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	信维通信	股票代码	300136
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢信	伍柯瑾	
办公地址	深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 2 楼	深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 2 楼	
传真	0755-86561715	0755-86561715	
电话	0755-33086079	0755-33086079	
电子信箱	ir@sz-sunway.com	ir@sz-sunway.com	

2、报告期主要业务或产品简介

坚守公司使命，为客户创造价值。公司始终坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，以材料为核心，通过对研发的持续投入，保持与国内、外知名大学和科研院所的合作与交流，加大对基础材料、基础技术的研究和积累，并以材料驱动业务发展，不断深化“材料->零

部件->模组”的一站式研发创新能力，为客户提供更丰富的产品和解决方案。

践行公司核心价值观，实现可持续发展。公司坚持以本分、客户满意、结果导向、追求极致、勇于担当为核心价值观，共识、共创、共担、共享，打造有战斗力的合伙人团队，通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展，实现可持续发展。在聚焦主业上，公司始终保持着较强的战略定力及战略落实、推进力，夯实消费电子核心领域业务的同时，积极挖掘新兴领域机会，布局具有前景的新兴产业项目，努力把产业做透做强，在市场波动以及持续动荡的外部环境中，为公司的长期健康发展积蓄力量，不断获得新的成长动能。

报告期内，公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC 器件、高精度连接器、声学器件、汽车互联产品、被动元件等产品，可广泛应用于消费电子、商业卫星通信、智能汽车、物联网/智能家居等领域。



信维通信是一家全球研发、运营、销售的公司，业务与客户已遍及全球。迄今，公司在全球拥有 26 家子公司、11 个研发中心和 5 个主要生产基地，员工 14,764 人，业务覆盖 7 个国家 17 个地区。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	13,539,515,572.44	13,371,351,405.04	1.26%	12,872,407,625.64
归属于上市公司股东的净资产	7,930,289,371.59	7,309,002,684.99	8.50%	7,029,589,379.32
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	8,909,779,803.93	8,743,610,645.71	1.90%	7,547,645,710.16
归属于上市公司股东的净利润	708,686,269.06	661,605,544.10	7.12%	521,403,065.93
归属于上市公司股东	643,360,331.38	538,106,812.49	19.56%	439,949,508.17

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	1,689,294,218.18	1,075,900,583.38	57.01%	1,818,388,216.72
基本每股收益（元/股）	0.7441	0.6865	8.39%	0.5389
稀释每股收益（元/股）	0.7375	0.6865	7.43%	0.5389
加权平均净资产收益率	9.32%	9.15%	0.17%	7.66%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,742,892,253.47	1,960,188,465.22	2,759,291,983.02	2,447,407,102.22
归属于上市公司股东的净利润	77,492,172.45	84,340,178.14	324,655,726.21	222,198,192.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,682,284.92	63,442,464.99	314,073,023.76	214,162,557.71
经营活动产生的现金流量净额	629,622,037.33	448,113,675.50	216,480,462.89	395,078,042.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	139,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	215,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
彭浩	境内自然人	19.48%	188,503,533.00	141,377,650.00	不适用				0.00
全国社保基金一零三组合	其他	3.20%	30,992,900.00	0.00	不适用				0.00
中国工商银行股份有	其他	1.59%	15,364,027.00	0.00	不适用				0.00

限公司 一易方 达创业 板交易 型开放 式指数 证券投 资基金						
中国农业 银行股 份有限 公司一 中证 500 交 易型开 放式指 数证券 投资基 金	其他	1.46%	14,119,228.00	0.00	不适用	0.00
深圳市 信维通 信股份 有限公 司一第 三期员 工持股 计划	其他	1.14%	11,000,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中 央结算 有限公 司	境外法 人	1.07%	10,388,595.00	0.00	不适用	0.00
全国社 保基金 二零三 组合	其他	0.93%	9,000,000.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法 人	0.89%	8,658,978.00	0.00	不适用	0.00
安耐德 合伙人 有限公 司一客 户资金	境外法 人	0.80%	7,765,946.00	0.00	不适用	0.00
中国工 商银行 股份有 限公司 一国泰 中证全 指通信 设备交 易型开 放式指 数证券 投资基 金	其他	0.73%	7,015,099.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司实际控制人彭浩先生与其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 经营情况概述

2025 年度，全球消费电子市场在技术迭代与政策扶持下呈现复苏态势，中国经济也在稳增长举措推动下逐步企稳。公司紧扣产业发展趋势，坚定立足自身的技术积淀，一方面夯实消费电子等第一增长曲线，另一方面加速向 AI 终端、商业卫星、智能汽车、机器人等新兴赛道拓展，不断拓宽第二增长曲线业务规模，全力朝着“产品领先+运营卓越”的技术驱动型平台企业方向稳步迈进。

报告期内，公司整体经营表现稳健，实现营业收入 890,977.98 万元，较上年同期实现增长 1.90%；归属于上市公司股东的净利润达到 70,868.63 万元，同比增长 7.12%；扣除股份支付影响后的净利润达到 73,898.85 万元，同比增长 10.50%；扣除非经常性损益的净利润达到 64,336.03 万元，同比增长 19.56%，同时毛利率提升至 22.79%，较上年增加 1.97 个百分点。公司持续加大重要战略产品研发投入、优化产品结构，通过逐步淘汰低毛利率产品，扩大高附加值新产品营收占比，稳步提升整体盈利水平，推动经营效率持续增强。报告期内，公司资产负债率为 41.43%，较去年同期下降 3.69 个百分点，继续保持健康的资产负债结构。

公司始终将“新行业、新客户、新技术、新产品”作为核心发展方向，经过前期的持续投入，第二增长曲线业务已展现出良好的发展势头，成功推动业务从单一的消费电子领域，向“消费电子+卫星通信+智能汽车+N”的多元协同格局转型，为后续业务规模的进一步扩张奠定了坚实基础。公司深耕射频通信模组、商业卫星通信器件及组件、车载电子及高端元器件等核心业务，既是国家战略性新兴产业的重要组成部分，也是数字经济的核心赛道，近年来先后受益于新基

建推进、5G-A 与 6G 技术研发提速、卫星互联网建设落地、智能网联汽车产业普及以及国产替代政策深化等多重利好，技术储备转化为实际产品的速度不断加快，产品落地量产、市场拓展落地、规模化盈利进程全面提速，长期发展的成长空间也随之进一步打开。在技术创新层面，公司坚持以市场需求和行业前沿技术为导向，积极联动国内外核心客户、顶尖高校与科研机构开展协同创新，围绕下一代通信技术、卫星互联、智能终端、车载应用等关键领域组建联合研发团队，集中力量攻克技术难题。目前，在高频射频器件、透明天线、卫星通信天线、高速连接方案以及高端 MLCC 等核心方向，已与多家行业头部客户建立起稳定的联合开发机制，多项合作项目顺利进入样品测试、性能优化或小批量试产阶段，为后续市场拓展储备了充足的技术与产品储备。

在产业布局方面，公司依托中央研究院为核心的全球研发体系，已建成 11 个研发中心、26 家子公司以及 5 个主要生产基地，业务版图覆盖 7 个国家的 17 个地区。自 2012 年启动海外布局以来，公司先后在 2019 年建成越南生产基地，2024 年完成越南基地扩建并新增墨西哥生产基地，同时启动深圳新总部基地建设，持续强化深圳技术研发与智能制造核心能力。这一完善的国际化布局，有效对冲了国际贸易局势带来的不确定性，进一步加大海外产能建设及业务规模，为全球客户提供了更高效、更全面的产品与服务支撑。

当前 AI 智能硬件呈现端侧轻量化、算力高密度化、云边端协同三大发展趋势，推动天线、射频模组、元器件、结构件等核心零部件需求由通用性能标准，向高频高速、高集成度、高散热、强抗扰方向实现结构性升级。公司凭借多年积累的技术经验与长期前瞻性布局，深度契合智能终端在高速率、低时延、多频段通信方面的核心要求，为客户提供一体化的整体解决方案。在天线与射频模组方面，公司持续巩固移动终端天线制造业单项冠军的优势地位，为各类智能终端产品提供高性能的天线及射频配套方案；在高精密连接器方面，公司依托自身射频技术、磁性材料等技术优势，重点发展高速连接器、磁性连接器、BTB 连接器等高端细分领域，相关产品技术水平深受客户认可；在精密结构件方面，公司针对可穿戴设备场景研发出轻薄化、高强度结构件，同时推出适配高密度电池的不锈钢电池壳，精准匹配细分市场需求；在散热方案上，公司自主研发的 TIM 热界面材料、液态金属以及高分子高导热材料，已成功切入芯片封装散热片、TIM1 材料等核心领域，即将实现量产应用于 AI 终端产品。此外，公司成功进入北美新客户的 AI 硬件供应链，为其提供从天线、无线充电到精密结构件的全链条综合解决方案。LCP 及毫米波天线模组方面，公司自主研发的 LCP 薄膜通过了美国 UL (Underwriter Laboratories Inc.) 认证，高频传输性能及可靠性等处于国内领先水平，已服务北美大客户，同时针对移动通信、智能网联汽车、卫星通信等相关领域的客户共同开展基于以 LCP 为代表的高分子先进材料的多种形态高性能毫米波天线解决方案的研究。公司 UWB 天线模组也已广泛应用于智能汽车钥匙、智能门锁、智能医疗设备、智能安防、智能音响等物联网及智能家居产品，有效拓展了物联网业务的应用边界。

通信应用方面，随着 5G-A 正式商用、6G 技术研发全面提速，再叠加人工智能、物联网、卫星通信等技术的深度融合，行业整体正朝着智能化、算力化、空天地一体化的方向加速演进。公司敏锐捕捉到这一行业趋势，重点布局柔性可重构天线、卫星通信相控阵天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线、光学透明天线、UWB 天线模组等核心技术领域，同时前瞻性布局 6G、数据中心、人工智能、人形机器人等前沿赛道，多项研发成果已进入系统仿真与验证测试阶段，可广泛应用于下一代移动通信、卫星互联、智能终端等多个领域，未来的应用场景与市场空间极具潜力。在技术研发层面，公司紧跟行业高频高速发展方向，围绕射频天线及模组、无线充电、高速连接器、高端元器件等关键环节持续开展技术攻关：射频天线产品，成功研发高频低损耗高分子、陶瓷材料，大幅提升高频信号传输效率与集成度；无线充电产品，布局 NFC、Qi2.0/Ki、高自由度充电等新一代技术，满足多样化充电需求；高速连接器产品，研发轻量化、低 Dk 介电材料，保障高速信号传输的完整性与稳定性。

商业卫星通信业务方面，全球低轨卫星互联网星座建设已进入实质性实施阶段，直接带动地面终端设备需求迎来快速增长。公司已构建起“低轨地面终端核心器件 + 相控阵天线 + 高频高速连接器 + 精密结构件”的完整业务布局，与行业头部客户建立深度合作关系，成功切入全球低轨卫星产业链的高价值环节。目前，面向低轨卫星接收终端的相控阵天线模组已实现批量出货，持续保持在商业卫星领域的领先优势，并不断深化与北美两大客户的合作；高频高速连接器在卫星通信领域也取得了突破性进展，已成为公司第二大主要下游应用领域，依托全球化的研发与制造能力，为全球客户提供高质量的产品与服务。

公司智能汽车电子业务同样迎来高速发展期。随着汽车智能化进程不断加快与新能源汽车的全面普及，单车对天线等电子部件的需求显著提升，汽车天线技术也从传统的离散设计，逐步向多频段高度融合、智能波束赋形的方向演进，

行业迎来全新的发展机遇。公司通过在天线与射频领域的技术积累，已成功进入国内外头部车企供应链，可提供车载天线、毫米波雷达模组、大功率无线充电模块、USB Hub 数据连接模块、定制化线束/连接器、Busbar、EMI/EMC 器件及精密结构件等全系列产品，汽车电子业务收入实现快速增长，预计成为公司重要的增量业务板块。

高端元器件（MLCC）业务方面，受益于 AI 服务器等新兴领域的快速发展，高容、宽温等高端 MLCC 产品的市场需求保持稳步增长态势。公司持续强化在材料配方、产品设计及工艺工程方面的研发能力，针对 AI 服务器场景完成高端 MLCC 系列化产品的全面布局：多款产品已实现稳定量产，产品性能与可靠性处于行业领先水平；大尺寸超高容产品的研发工作按计划推进，关键指标验证已顺利通过；目前，公司已累计获得相关专利 60 余项，成功填补国内高端 MLCC 技术空白，为国产替代进程贡献了重要力量。

透明天线技术作为公司的重要创新突破，已成功攻克高透材料与金属线路兼容、复杂曲面成型、多频段信号耦合干扰等多项核心技术难题。公司自主研发的高透光、优电性能新型复合材料，已拓展至薄膜、玻璃、玻纤基材等多个领域，并持续优化材料的耐候性与加工适配性；针对北美大客户，已完成多批次产品送样，部分项目成功进入小批量试产评估阶段；在车载场景落地方面，与主流车企及核心玻璃供应商完成技术对接与样品送样，正在开展车载可靠性验证，为后续规模化应用做好充分准备。

在电子信息技术不断变革的快速发展浪潮下，公司坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，重视研发投入，积极把握技术创新趋势，挖掘客户需求，将技术驱动融合在产品服务中，始终保持着源源不断的技术创新活力。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共申请专利 5498 件；2025 年 1 月至 12 月新增申请专利 716 件，其中 5G 天线专利 238 件，LCP 专利 8 件，UWB 专利 18 件，WPC 专利 25 件，BTB 连接器专利 28 件，MLCC 专利 4 件，声学结构专利 169 件。报告期内，公司研发投入约 63,343.76 万元，占公司 2025 年营业收入的 7.11%，保持较高的研发强度，不断积累自身在基础材料、基础技术上的核心能力：

(1) 基础材料：以村田、TDK、京瓷等优秀企业作为学习标杆，公司不断夯实高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、散热材料等核心材料平台，加强在核心材料上的技术投入，持续提升材料核心竞争力。在 高分子材料领域，公司具有深厚的研发实力和丰富的应用经验，我们开发的 LCP 薄膜、LCP 柔性覆铜板、MPI 柔性覆铜板等产品目前已在国内外消费类终端客户的 RF 传输线、毫米波传输线、UWB 天线等应用领域实现量产，公司可为客户提供从薄膜材料到模组的一站式解决方案，在高频高速方案中有着广泛应用；LCP 薄膜作为公司自主开发的核心材料之一，它具有耐高温且热稳定性好、高频信号下传输损耗低、占用空间小等优点，在 5G 通信领域产品中已经大量使用，同时公司开展了 6G 前沿技术及先进材料的研发，应用前景会更加广泛。除了对已有产品的创新升级外，公司进一步优化 LCP 材料性能，深化其在商业卫星通信、智能汽车等领域的应用，联合客户开展基于 LCP 材料的高性能毫米波天线解决方案研究，以实现更广泛的商业价值和市场竞争。在磁性材料上，公司有着深入而广泛的研究，已开发高频高功率低损耗磁性材料，是下一代无线充电技术的核心材料，在国内外客户移动终端的发射端均已应用并供货；另外，磁性材料还可帮助提升天线、射频模组等多类产品的竞争力，公司持续优化磁性材料性能，进一步拓展其在车载无线充电、卫星通信器件中的应用，为公司新兴业务的落地提供核心材料支撑。在陶瓷材料上，公司具备陶瓷材料和基础配方等研发能力，对 MLCC 等产品的生产具有重要意义，有助于降低生产成本，提高产品质量，增强公司产品的市场竞争力；公司研究的高频低损耗陶瓷材料在通信领域有很好的应用，特别是在高频通信和微波通信领域；通过对陶瓷材料应用的深入研究，可以进一步提升天线、阻容元件等产品性能，为客户提供更优质、高效的通信解决方案，多款高容 MLCC 产品已成功通过大客户测试，填补了国内高端 MLCC 技术空白。在散热材料领域，公司同时掌握基于液态金属和高分子材料的先进配方技术，精准匹配先进封装及算力芯片等高端应用场景的散热需求，已为北美客户提供核心芯片封装散热器器件；未来，公司还将继续优化散热材料性能，拓展其在卫星终端、车载芯片、光模块等场景的应用，进一步深化与北美客户的合作，提升产品市场占有率。

(2) 基础技术：公司依托以中央研究院为核心的全球 11 个研发中心，开发前沿技术产品。公司在射频领域拥有显著的研发实力和技术优势，围绕 5G-A/6G 的技术目标，积极开发柔性可重构天线、卫星通信相控阵天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线、光学透明天线、UWB 天线模组等。随着 5G-A/6G 技术的不断发展，对终端天线模组的要求也越来越高，天线模组需要能够支持更高、更宽的频带范围，以确保在各种通信场景下都能实现稳定的信号传输；而终端设备的不断小型化和轻薄化，对天线模组的尺寸和集成度也形成了严格的限制，对天线材料及工艺也提出了更高的要求，

公司对 5G-A/6G 天线模组做了大量的研究工作，公司还在无线充电领域储备了 NFC 无线充电、Qi2.0/Ki、高自由度充电技术等；在高速连接器领域正在开展满足高频高速需求的轻量化、低 Dk 介电材料的研发。

展望未来，公司将继续依托全球化研发与制造体系，持续深化技术迭代与产品创新，不断优化“存量深耕 + 增量突破”研发布局，积极把握产业创新机遇，始终坚持对基础材料与基础技术的研发投入，进一步扩大新产品与新兴领域业务营收占比，有效降低单一业务与单一地区带来的经营风险。同时，公司将持续强化预算管理、风险控制，完善内部管理机制与运营措施，不断夯实核心竞争力、提升运营管理水平，积极履行 ESG 社会责任，坚持绿色可持续发展道路，稳步改善各项经营与财务指标，在全球产业数字化、智能化转型浪潮中持续创造更大价值。